

Investition in den Direktvertrieb



Unser komplettes Vertriebsteam in Berlin (v.l.n.r.):
Christa Simon, Michaela Iden, Stephanie Schuppe, Silke Nauermann, Bärbel Nohns,
Ingrid Biedemann, Dr. Christoph Lehnberger, Tobias Wolter, Burkhard Knoll

Bereits mit der zweiten **Neueinstellung** innerhalb eines Jahres haben wir unser Berliner Vertriebsteam weiter aufgestockt.

Ab sofort stellen wir auch in Nord- und Westdeutschland auf Direktvertrieb um. Jetzt können Sie uns im gesamten deutschsprachigen Raum ohne Umwege erreichen.



Wir haben entschieden, unsere Kapazitäten im technischen Vertrieb zu erweitern,

- um Ihre hohen Erwartungen an eine kompetente Beratung zu erfüllen,
- um auf Ihre Anfragen auf kürzestem Wege flexibel und konstruktiv reagieren zu können,
- um Sie technologisch immer aktuell auf dem Laufenden zu halten.

In Kürze werden wir Ihnen Ihre direkten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus unserem neuen Vertriebsteam vorstellen. Neugierig? Dann schauen Sie doch schon mal vorbei unter

www.andus.de

Im Zuge der internen Reorganisation trennt sich **ANDUS** zum Jahresende von seinem langjährigen Handelspartner, der **Hubert Schroeter KG**. Wir bedanken uns bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hubert Schroeter KG für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Als **„einzigartig“** wird unsere technologische Kompetenz von vielen unserer Kunden geschätzt. Durch den Direktvertrieb können jetzt alle Kunden das Zusammenspiel von fundiertem Fachwissen im Vertriebsteam und umfassenden Fertigungsfähigkeiten der Leiterplattenproduktion unmittelbar erleben.

Ein Team - ein Versprechen:

Wir lassen Ihre Ideen Realität werden!

Haus-Information

Gefragtes Fachwissen

In zahlreichen Veranstaltungen leistet **ANDUS** nach der Urlaubszeit jetzt wieder einen Beitrag zum Technologietransfer. Ein Schwerpunkt des Interesses liegt nach wie vor beim Thermischen Management auf Leiterplatten, um hohe Ströme und Leistungen sicher in den Griff zu bekommen. Weitere Themen sind Microflexe, Langflexe und andere Neuheiten.

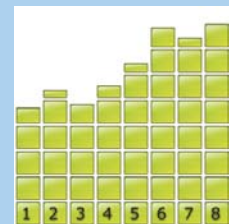
Alle Veranstaltungen für die nächste Zeit finden Sie unter

www.andus.de

Möchten Sie nicht bis zum nächsten Termin warten? Können Sie sich keine Zeit für ein umfangreiches Seminar nehmen? Dann geben wir Ihnen auch gerne persönlich technologische Auskünfte. Rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne ausführlich zu Ihrem konkreten Projekt.

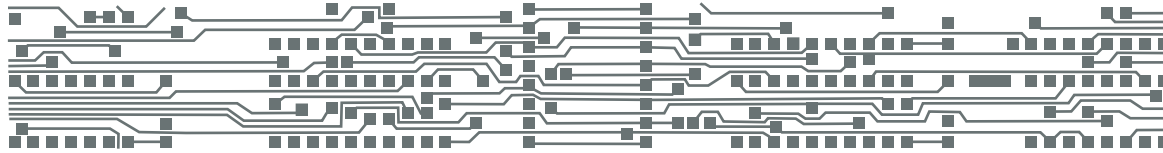
Neuer Produktionsrekord

Noch in keinem Monat zuvor hat **ANDUS** so viele Leiterplatten produziert wie im August dieses Jahres. Gezielte Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung

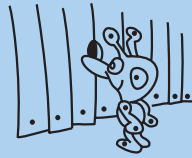


erbrachten seit Anfang des Jahres eine Steigerung der produzierten Leiterplattenfläche von mehr als 70 % und das, ohne an der Termintreue zu rütteln. Ein Erfolg, den wir zukünftig mit weiteren Optimierungen noch übertreffen werden.





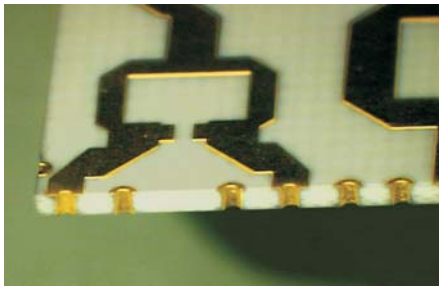
Blick in die Technik:



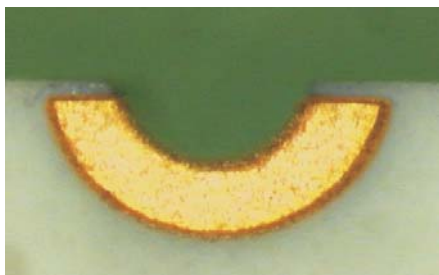
Neue feinere Kantenkontakte

Board-zu-Board-Verbindungen werden heute meist über Aufsteckmontage ("huckepack") mittels Stiftleisten realisiert.

Alternativ dazu können einseitig bestückte Module im Reflow direkt auf Basisplatten gelötet werden. Zu diesem Zweck weisen die Board-on-Board-Module Kantenkontakte auf, die als SMD-Anschluss pads dienen.

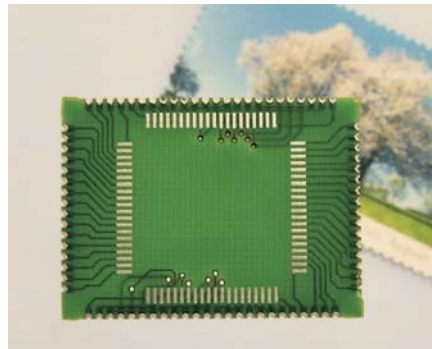


ANDUS hat ein neues Verfahren qualifiziert, bei dem jetzt auch feinere Durchkontaktierungen präzise geteilt werden können. Gleichzeitig wurde die Prozesssicherheit verbessert und die Ausbeute maximiert, was besonders bei hohen Anschlusszahlen für mehr Sicherheit bei der Kontaktierung sorgt.



Kantenkontakt eines HF-Moduls:
0,25 mm-Vias gedrittelt, Pitch 0,75 mm

Das gesamte System wird durch den Direktkontakt der Leiterplatten wesentlich flacher. Daneben entfällt der Platzbedarf für die Stiftleisten und die Sockel. An deren Stelle sind lediglich die Anschlussflächen auf dem Basisboard und die Pads auf der Konturkante des Moduls zu designen.



Interposer mit Kantenkontakten
für die Board-on-Board-Montage

Die Vorteile der neuen Finepitch-Kantenkontakte kommen z.B. bei Interposern zum Tragen, welche den Leiterplatten-Footprint von abgekündigten Bauteilen mit den Pads der neuen, meist kleineren Bauteile verbinden. Anstelle eines neuen Layouts für die gesamte Basisplatte genügt ein zusätzlicher Adapter mit Kantenkontakten.

Eine weitere Anwendung nutzt die besondere Geometrie der Anschlussstellen: HF-Filter und andere HF-Strukturen, z.B. auf PTFE, können direkt in Leiterplattentechnik gefertigt und mit Kantenkontakten versehen werden. Die Lötverbindung weist kaum Störstellen für die HF-Signale auf und verbessert die Signalintegrität.

Zurückgeblickt (Folge 7)

Manche historische Oberfläche wird auch heute noch nachgefragt

Bei **Zinn/Blei aufgeschmolzen** wird die als Ätzresist abgeschiedene Zinn/Blei-Schicht im Infrarot-Reflowofen über den Schmelzpunkt erwärmt. Das Lot zerfließt und umhüllt auch die Flanken der Leiter. Mit der Einführung von Lötstopplack verschwand diese Oberfläche, da dieser beim Umschmelzen wie eine Orangenhaut zusammenschrumpft.

Bei der heute noch erhältlichen **Walzen- oder Rollenverzinnung** wird das flüssige Lot durch Edelstahlwalzen geglättet.

Als wirklich antik kann man das **Hot-Oil-Levelling** bezeichnen, bei dem die Leiterplatten wie beim Hot-Air-Levelling in das heiße Zinnbad eingetaucht werden. Hier sorgt jedoch ein Ölbad über dem Zinn dafür, dass Durchkontaktierungen mit dem durch Düsen gepumpten heißen Öl „freigeblasen“ werden.



Hot-Oil-Levelling in den '80er Jahren

Übrigens...

... kenn' Se den schon?

„Ich habe ein neues Hörgerät. Ich höre jetzt alles.“ - „Und, was kostet das?“ - „Nein, das rostet nicht.“

